Pressemitteilung

**LANline Tech Forum München: Classic-Sponsor tde mit innovativem Konzept und animiertem Vortrag**

**Für effiziente, flexible und zukunftssichere Datacenter:**

**tde präsentiert das smarte Rack**

**Dortmund, 25. Mai 2022. „Das smarte Rack“ stellt die tde – trans data elektronik GmbH in den Mittelpunkt ihres Auftritts auf dem diesjährigen LANline Tech Forum in München. Damit rückt der Branchenpionier für höchste Packungsdichten und Technologieführer der Mehrfasertechnik MPO seinen Leitgedanken in den Mittelpunkt und informiert Besucher darüber, wie sich Datacenter effizient, flexibel und zukunftssicher gestalten lassen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die erfolgreiche tML-Systemplattform für die einfache Migration zu höheren Übertragungsraten: Das modulare Verkabelungssystem integriert alle derzeit gängigen sowie künftigen Steckgesichter, lässt damit Netzwerktechnikern alle Anschlussmöglichkeiten offen und ist dabei ebenso investitionssicher wie nachhaltig designt.**

Die Anforderungen an moderne Datacenter sind enorm: Sie müssen effizient und flexibel sowie zugleich zukunftssicher konzipiert sein. Hinzu kommt: Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. „Deshalb ist es entscheidend, das Datacenter vom Rack her zu denken“, sagt André Engel, Geschäftsführer der tde trans data elektronik GmbH, und fährt fort: „Denn was für das einzelne Rack gilt, gilt im Großen für das gesamte Datacenter.“

Dafür hat die tde das Konzept des smarten Racks entwickelt: Im Mittelpunkt steht das tML – tde Modular Link System. Die zuverlässige und bewährte Plattform ermöglicht Netzwerktechnikern die schnelle Installation. Dank Plug-and-play lassen sich selbst komplexe Netzwerke einfach realisieren. Zugleich punktet das tML mit sehr hoher Packungsdichte – bis zu acht LWL- oder TP-Module lassen sich zusammen mit einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen – und lässt sich jederzeit flexibel umbauen oder erweitern.   
Zusammen mit einer Systemgarantie von 25 Jahren erhalten Datacenter höchsten Investitionsschutz bei gleichzeitig größtmöglicher Nachhaltigkeit. Die spezielle Bauform der tML-Module eröffnet zudem eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten im Patchbereich: Neben den derzeit gängigen Steckverbindern lassen sich die Einzelfasersteckerbinder MDC von US Conec ebenso wie die CS- und SN-Steckverbinder von Senko problemlos in das tML-System integrieren und die Packungseffizienz

erheblich steigern. „Für Highspeed-Übertragungen von 400G und mehr stehen Unternehmen dank des smarten Racks vielfältige Optionen offen,“ sagt Engel und weiter: „Im Sinne einer zukunftsfähigen Infrastruktur sollten sie im Rückraum in jedem Fall auf eine hochfaserige MPO-Verkabelung setzen. So wird das Rack und damit das Datacenter effizient, flexibel und zukunftssicher.“

*Visuelles Highlight: Animierter Vortrag*Sein Konzept des smarten Racks erläutert der Netzwerkexperte sehr anschaulich am 30. Juni 2022 von 14:50 bis 15.20 Uhr: „Unser Vortrag wird ein visuelles Highlight und spiegelt damit die Qualität unserer Lösungen wider: Klar im Stil, reduziert auf das Wesentliche und dabei hochmodern mit 3D-Animationen und Visualisierungen der Hauptfeatures,“ sagt Engel.

**LANline Tech Forum zum Thema „Verkabelung, Netze und Infrastruktur”**

**29. und 30. Juni 2022**

**Hilton Airport München**

**Terminalstraße Mitte 20   
85356 Oberding / München**

**Weitere Informationen und Anmeldung unter:** [**https://events.weka-fachmedien.de/tech-forum-muenchen/home/**](https://events.weka-fachmedien.de/tech-forum-muenchen/home/)

**Der VIP-Code für die kostenlose Teilnahme lautet: 0622TFMUCTDE**

**Über die tde – trans data elektronik GmbH**  
Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).   
Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: [www.tde.de](http://www.tde.de/) sowie auf [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/tde-trans-data-elektronik-gmbh/), [Twitter](https://twitter.com/tdeConnect) und [Xing](https://www.xing.com/companies/tde-transdataelektronikgmbh/updates).   
  
**Unternehmenskontakt**tde – trans data elektronik GmbH, Vertriebsbüro Dortmund  
André Engel, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46, D - 44135 Dortmund  
Tel. +49 231 160480, Fax +49 231 160933, [info@tde.de](mailto:info@tde.de), [www.tde.de](http://www.tde.de/)

**Pressekontakt**EPR Advisors, Maximilianstraße 50, D - 86150 Augsburg

Frauke Schütz, Tel: +49 821 4508 7916, [fs@epr-online.de](mailto:fs@epr-online.de)

Elke Thiergärtner, Tel: +49 821 4508 7912,et@epr-online.de

www.epr-online.de